



[kingston.com/emcp](http://kingston.com/emcp)

## eMCP

### La perfecta solución de almacenamiento de consumo eficiente para aplicaciones móviles, integradas y de IdC de espacio limitado

Kingston ofrece una gama de componentes compatibles con la norma JEDEC. eMCP combina un almacenamiento con tarjeta multimedia integrada (eMMC) con un módulo DRAM de doble velocidad de datos y bajo consumo (LPDDR) dentro de un Paquete de múltiples chips (MCP) que ocupa un mínimo espacio. Esta solución permite una mejor integración y reduce el tamaño general. eMCP es una combinación ideal de almacenamiento y memoria para sistemas de espacio restringido, como teléfonos inteligentes, ponibles y diversos dispositivos del "Internet de las cosas" (IdC).

## PRINCIPALES VENTAJAS

- Solución Flash NAND administrada que simplifica el diseño y la sostenibilidad del producto con una interfaz eMMC estándar. Esto reduce significativamente la complejidad del diseño y el ciclo de homologación.
- La combinación de memoria y almacenamiento altamente integrada reduce el espacio en el diseño del sistema, convirtiéndolo a eMCP en la solución ideal para aplicaciones de pequeño factor de forma.
- La DRAM reduce el consumo eléctrico, lo cual convierte a eMCP en una solución óptima para numerosas aplicaciones alimentadas por batería, como ponibles y productos móviles del IdC.
- Reducción de la complejidad de la lista de materiales al disminuir el número de componentes.
- Disponibilidad de múltiples configuraciones de firmware a la medida de los requisitos de rendimiento, alimentación y vida útil de su aplicación.

## SEGMENTOS DE MERCADO



Teléfonos inteligentes y Tabletas



Ponibles



Aceleradores de IA



IdC

## NÚMEROS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES DE eMCP

### eMCP basado en LPDDR3

Número de referencia	Capacidad		Estándar		Paquete	FBGA	Temperatura de servicio
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C a +85°C
08EM08-N3GML36	8	8	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C a +85°C
16EM08-N3GTB29	16	8	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C a +85°C
16EM16-N3GTB29	16	16	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C a +85°C
32EM16-N3GTX29	32	16	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,0	221	-25°C a +85°C
32EM32-N3HTX29	32	32	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,1	221	-25°C a +85°C
64EM32-N3HTX29	64	32	5.1	LPDDR3	11,5x13,0x1,1	221	-25°C a +85°C

### eMCP basado en LPDDR4x

Número de referencia	Capacidad		Estándar		Paquete	FBGA	Temperatura de servicio
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM08-M4EM627	4	8	5.1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	149	-25°C a +85°C
16EM16-M4CTB29	16	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C a +85°C
32EM16-M4CTX29	32	16	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C a +85°C
32EM32-M4DTX29	32	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C a +85°C
64EM32-M4DTX29	64	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,0	254	-25°C a +85°C
128EM32-M4DTX29	128	32	5.1	LPDDR4x	11,5x13,0x1,1	254	-25°C a +85°C